

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】令和7年4月7日(2025.4.7)

【公開番号】特開2024-96265(P2024-96265A)

【公開日】令和6年7月12日(2024.7.12)

【年通号数】公開公報(特許)2024-130

【出願番号】特願2024-73131(P2024-73131)

【国際特許分類】

C 08 L 101/00(2006.01)

10

C 08 K 3/013(2018.01)

【F I】

C 08 L 101/00

C 08 K 3/013

【手続補正書】

【提出日】令和7年3月27日(2025.3.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

20

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

硬化性樹脂と、無機充填材とを含み、前記無機充填材は平均粒子径が0.07μm～0.3μmの無機粒子Aと、前記無機粒子A以外の無機粒子Bと、を含み、

前記無機粒子Aの比表面積が1.5m²/g以下であり、

前記無機粒子Bの体積平均粒子径が0.5μm～1.5μmである、

樹脂組成物。

【請求項2】

前記硬化性樹脂が、エポキシ樹脂である、請求項1に記載の樹脂組成物。

30

【請求項3】

前記樹脂組成物中の前記エポキシ樹脂の含有率が、0.5質量%～5.0質量%である、請求項2に記載の樹脂組成物。

【請求項4】

前記無機充填材の含有率は、前記樹脂組成物全体の3.0体積%～9.0体積%である、請求項1～請求項3のいずれか1項に記載の樹脂組成物。

【請求項5】

前記無機粒子Aの割合が前記無機充填材全体の3質量%～10質量%である、請求項1～請求項4のいずれか1項に記載の樹脂組成物。

40

【請求項6】

電子部品装置の封止材として用いるための、請求項1～請求項5のいずれか1項に記載の樹脂組成物。

【請求項7】

素子と、前記素子を封止する請求項1～請求項6のいずれか1項に記載の樹脂組成物の硬化物とを備える電子部品装置。

50